

Mate2016

22nd Symposium on "Microjoining and Assembly Technology in Electronics"

第22回「エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実装技術」シンポジウム

日 時： 平成28年2月2日（火）、3日（水）

場 所： パシフィコ横浜 会議センター（横浜市西区みなとみらい1丁目1-1）

主 催： （一社）スマートプロセス学会 エレクトロニクス生産科学部会
（一社）溶接学会 マイクロ接合研究委員会

《センシング技術で創造する安全・安心な社会》

日本のエレクトロニクス産業は、この20年間、高機能化、高信頼化、小型化、低コスト化の技術開発に支えられた新たな電子デバイス・部品を組み込んだ電子システム創成の下、日本の高度成長を牽引してきました。今後も日本が世界を先導し続けるには、生産技術を科学的に探求することはもちろんのこと、既存の学問領域、設計・生産技術などの領域を越えて、エレクトロニクスを取巻く科学技術、経営・生産システム、価値システム、などの広い範囲を取り込んだグローバルなオプティマイゼーションとそれに基づくシステムインテグレーションが不可欠になってきています。本シンポジウムは、これら生産技術に関する最新の研究・開発に関する研究者相互の情報交換の場をより広くかつ定期的に持ち、生産の科学と技術の進展を促すことを目的として企画開催されます。

共 催： （一社）エレクトロニクス実装学会
（公社）化学工学会 エレクトロニクス部会
（一社）レーザ加工学会

協 賛： 応用物理学会、軽金属学会、精密工学会、電子情報通信学会、日本機械学会、
日本金属学会、日本材料学会、日本溶接協会

参加申込〆切：平成28年1月15日(金)

参加申込：下記シンポジウムURLより、期日までに参加登録を行って下さい。参加費のお支払いは銀行振込にてお願い致します。なお、振込期日までにお振込みが間に合わない場合は、当日現金にてお支払い願います。

【振込先】 三井住友銀行 千里中央支店 普通口座 0978673
口座名：Mate組織委員会 [メイトソシキイインカイ]

【振込期日】平成28年2月29日（月）

【URL】 <http://sps-mste.jp/mate2016/src/>

懇親会：シンポジウム1日目に懇親会を開催します。シンポジウム参加申込時にお申し込みください。

（日 時）平成28年2月2日（火）18:00～

（場 所）パシフィコ横浜 会議センター6階
「バイブリッジカフェテリア」

（参加費）5,000円

《参加費》

主催団体個人会員	：20,000円
大学・国公立研究機関	：20,000円
口頭発表者	：20,000円
主催団体維持・賛助会員	：25,000円
共催団体会員	：25,000円
協賛団体会員	：30,000円
一 般	：35,000円
学 生	：10,000円

Mate 2016 プログラム

2月2日(火)

時間	A 会場	B 会場	C 会場
8:50	開会の挨拶 Mate2016組織委員会委員長 藤本 公三 (A会場)		
9:00 ~ 10:40	[A-1] ソルダリング 1. パワーモジュール向けNiめっき/Sn-0.7Cuはんだ接合界面の高耐熱化技術 *門口卓矢(トヨタ自動車㈱, 大阪大学), 武直矢(トヨタ自動車㈱), 山中公博(中京大学), 長尾至成, 菅沼克昭(大阪大学) 2. Sn-Ag-Cu 合金ボールの凝固過程で発生する Ag ₃ Sn 相成長に与える冷却速度と組成の影響 *秋山真之介, 田崎 学, 早坂光典, 志賀康紀(パナソニック㈱) 3. Sn-Ag-Cu 系鉛フリーはんだへの Ni 添加がはんだ付け性に及ぼす影響 *重田晃二, 出田吾朗, 宮本照雄(三菱電機㈱) 4. Injection Molded Solder 技術を用いた微細はんだバンピングに対するはんだ濡れ性の影響 *青木豊広, 中村英司, 久田隆史, 森裕幸, 折井靖光(日本アイ・ピー・エム㈱) 5. SnO ウィスカの成長メカニズムとフラックス残渣自体の絶縁抵抗劣化 *齋藤 彰(㈱村田製作所)	[B-1] プリントブルエレクトロニクス 31. Ag ナノインクのディスペンサ描画による GaN 系青色 LED 電極の作製と評価 *柏木行康, 齊藤大志, 松川公洋, 中許昌美(大阪市立工業研究所), 重宗 翼, 小泉 淳, 児島貴徳, 藤原康文(大阪大学), 新郷正人, 伊藤尊史, 塩島謙次(福井大学), 垣内宏之, 青柳伸宜, 吉田幸雄(大研化学工業㈱) 32. 導電性および絶縁性フィラーを二元分散した伸縮性印刷配線の疲労特性評価 *板橋洋介, 井上雅博, 多田泰徳(群馬大学) 33. 低温導体化銅ペースト *浦島航介, 米倉元気, 小川禎宏(日立化成㈱) 34. スクリーン印刷技術による高性能ミリ波配線技術 *堀部雅弘, 吉田 学(産業技術総合研究所)	[C-1] 熱マネジメント 59. 【講演】3D-ICの為の高性能マイクロチャネル冷却システム *K.Suzuki, H. Kudo, K. Fujimoto(Dai Nippon Printing), I. Kinofuchi, Y. Matsumoto(University of Tokyo), A. Tsukune, Y. S. Kim, and T. Ohba(Tokyo Institute of Technology) 60. モバイル機器向け薄型ループヒートパイプの開発 *塩賀健司, 水野義博, 阿部知行(㈱富士通研究所) 61. 相変化を用いた冷却ユニットの性能予測に関する研究 *蜂矢真弘, 千葉正樹, 吉川 実(日本電気㈱) 62. 局所加熱技術と精密熱解析技術の応用 *岡田 徹, 佐藤裕尚(富士通アドバンステクノロジ㈱)
10:40	休憩		
10:50 ~ 12:50	[A-2] ソルダ材料 6. Ag および Cu を添加した In-48wt%Sn はんだ合金の組織と機械的性質 *上村泰紀, 清水浩三, 野村健二, 作山誠樹(㈱富士通研究所) 7. 接合強度におよぼす添加元素の影響 *山内 啓, 竹之内郁人, 黒瀬雅詞(群馬工業高等専門学校) 8. Bi 単結晶の塑性変形挙動とその機構 *谷中勇一, 苅谷義治(芝浦工業大学), 渡邊裕彦, 外園洋昭(富士電機㈱) 9. Sn-1.0Ag-0.7Cu-1.6Bi-0.2In 低銀鉛フリーはんだの疲労特性に及ぼす負荷条件の影響 *高橋祐樹, 荘司郁夫(群馬大学) 10. Sn-5Sb 微小試験片の疲労特性に及ぼす温度の影響 *小林恭輔, 荘司郁夫(群馬大学), 外園洋昭, 西村芳孝(富士電機㈱) 11. はんだペースト増粘メカニズムの研究 *許 育甄, 平塚大祐, 山本哲也(㈱東芝)	[B-2] 固相・界面接合 35. マグネシウム空気電池の高出力化に関する研究 *板倉啓二郎, 平木博久, 内田成明, 筒井剛大, 高橋康夫(大阪大学) 36. 超塑性材料の固相接合における微小空隙消失機構解析 *梨木悠介, 衛中 皓(大阪大学), 前田将克(日本大学), 高橋康夫(大阪大学) 37. 473KにおけるFeとSnの固相反応拡散による化合物の成長挙動 *梶原正憲, 井野元誠(東京工業大学) 38. Sn-Ag 多層薄膜を用いたダイボンド部の高温信頼性評価 *多田羅哲, 福本信次, 松嶋道也, 藤本公三(大阪大学) 39. p型GaN中の水素除去促進のための通電熱処理とその電気特性改善効果 *土田啓介, Aiman bin Mohd Halil, 高橋康夫(大阪大学), 前田将克(日本大学) 40. 純 Al/SUS304 の固相接合強度に及ぼす金属塩生成処理の効果 *齋藤広輝, 小山真司(群馬大学)	[C-2] 樹脂実装プロセス 63. 機能性樹脂強化ソルダペーストを用いたレーザー駆動マイクロアセンブリ *安田清和(大阪大学) 64. 液状モールドアンダーフィル材(Liquid MUF)の通信系モジュールへの適用 *高尾知哉, 石川有紀, 雪丸城司, 池田和広(サンユレック㈱) 65. ハイブリッド樹脂実装における気泡発生要因の解明 *藪田康平, 福本信次, 松嶋道也, 藤本公三(大阪大学) 66. 高耐熱粘着シートの開発 *石川佳寛, 藤井飛鳥, 音田慎吾, 柏崎 史, 森 貴裕(㈱ADEKA) 67. 銅系導電性接着剤の大気キュア過程での導電特性変化に及ぼすバインダケミストリの影響 *井上雅博, 庭山泰一, 坂庭慶昭, 多田泰徳(群馬大学) 68. 低融点金属含有による導電性樹脂の特性向上 *武知佑輔, 松嶋道也, 福本信次, 藤本公三(大阪大学)
12:50	昼食休憩		
13:50 ~ 15:30	<プレナリーセッション> 「センシング技術で創造する安全・安心な社会」 (A会場) 1. “ぶつからないクルマ?”スバルが生んだアイサイトの秘密 樋渡 穰(富士重工業㈱) 2. ウエアラブル機器の実装技術の現状と展望 間ヶ部 明(セイコーエプソン㈱)		
15:45 ~ 17:45	<ポスターセッション>、ポスタープレゼン 15:45~16:25(A会場)、パネル説明 16:30~17:45、Coffee Break(3階 フォワイエ) P-1. PoP用Cuボールはんだ接合におけるセルフアライメント性と明度値による酸化膜厚測定 服部貴洋(千住金属工業㈱), 川崎浩由(千住金属工業㈱, 九州工業大学), *六本木貴弘, 相馬大輔, 佐藤 勇, 川又 司(千住金属工業㈱), 荒木孝司, 柘植頭彦(九州工業大学) P-2. 有機および無機表面コーティングによる Cu ボールのセルフアライメント性向上 *西野友朗(千住金属工業㈱), 川崎浩由(千住金属工業㈱, 九州工業大学), 六本木貴弘, 相馬大輔, 佐藤 勇, 川又勇司(千住金属工業㈱), 平尾浩彦, 田阪 淳(四国化成工業㈱), 荒木孝司, 柘植頭彦(九州工業大学) P-3. 低 BG α 線量測定における検出効率のエネルギー依存性と正確な α 線量特性に与える影響 *川崎浩由(千住金属工業㈱), Brett M. Clark(Honeywell Electronic Materials), 西野友朗(千住金属工業㈱), Michael S. Gordon(IBM TJ Watson Research Center) P-4. 導電性接着剤の Au めっきに対する電気特性 *野村昭博, 釣賀大介, 高岡英清(㈱村田製作所) P-5. SUS304 鋼の固相接合強度に及ぼす金属塩被膜処理効果とその持続性 *常藤達礼, 小山真司(群馬大学), 白鳥智美(㈱小松精機工作所) P-6. Fe 基ろうによる SUS304 ろう付部の腐食挙動と電気化学的性質 *角田貴宏, 石 康道, 荘司郁夫(群馬大学), 松康太郎, 田口育宏(東京プレイズ㈱) P-7. 耐酸化性と焼結性に優れた導電性銅ペースト焼結材について *小山 優, 福本邦宏(協立化学産業㈱) P-8. Pb フリーや入りはんだ用エポキシ系フラックスの開発 *雁部竜也(富士電機㈱), 戸田吉洋(トクセン工業㈱), 大熊 章(松尾ハンダ㈱), 岡本健次(富士電機㈱) P-9. In-Sn はんだの微細接合部におけるエレクトロマイグレーション挙動 *大藪悟志, 佐藤 茜, 上西啓介(大阪大学), 上村泰紀, 作山誠樹(㈱富士通研究所) P-10. 機能性樹脂強化ソルダペースト中のはんだ粒子のレーザー駆動ぬれの観察 *北村洪成, 安田清和(大阪大学) P-11. Sn-Ag-Bi-In 系はんだの相変態と耐熱疲労特性に及ぼす Sb 添加の影響 *乗峯笙汰, 三原一樹(大阪大学), 日根清裕(大阪大学, パナソニック㈱), 酒谷茂昭, 秋山真之介(パナソニック㈱), 上西啓介(大阪大学) P-12. 3D 積層に向けた常温による SiO ₂ /SiO ₂ 接合技術 *内海 淳, 堤圭一郎, 井手健介(三菱重工業㈱), 一柳優子(横浜国立大学) P-13. 金属スズ微粒子の合成と低温焼結性能 *米澤 徹, 白井宏明, 石田洋平, Mai Thanh Nguyen(北海道大学) P-14. 電子機器冷却における CFD を用いた逆解析から得られる感度情報の有効活用 *大串哲朗, 村上政明, 池島 薫, 高野公敏, 桃瀬一成(㈱アドバンスドナレッジ研究所) P-15. Ag ナノ粒子焼結接合部の疲労信頼性解析 *木村 良, 塩田竜太郎, 苅谷義治(芝浦工業大学), 水村宜司, 佐々木幸司(ナミックス㈱) P-16. 低弾性化技術を用いた低温焼結性ナノ銀ペースト *佐々木幸司, 水村宜司(ナミックス㈱) P-17. 超音波 Al リボン接合過程における界面凝着挙動のその場観察 *高岡勇介, 三澤浩太(大阪大学), 前田将克(日本大学), 高橋康夫(大阪大学) P-18. マグネシウム空気電池の電流密度に関する一考察 *筒井剛大, 板倉啓二郎, 平木博久, 内田成明, 高橋康夫(大阪大学) P-19. 放射光化学反応による金属ナノ粒子生成 *山口明啓(兵庫県立大学), 岡田育夫(名古屋大学), 福岡隆夫(兵庫県立大学), 石原マリ(兵庫県立工業技術センター), 内海裕一(兵庫県立大学) P-20. マニュアルソルダリングにおけるセラミックコンデンサのき裂発生抑制策の検討 *川添徹也(大阪大学), 山下浩儀, 宮本照雄(三菱電機㈱), 藤本公三(大阪大学)		
18:00	懇親会 (6階 ベイブリッジカフェテリア)		

2月3日(水)

時間	A 会場	B 会場	C 会場
8:50 ~ 10:50	[A-3] パワーデバイス(1) 12. 高温動作対応 3. 3kV SiC ハイブリッドモジュールの開発 *金井直之, 金子悟史, 堀元人, 池田良成, 望月英司, 高橋良和(富士電機株) 13. 高温動作対応技術を適用した第7世代 IGBT モジュール *百瀬文彦, 能川玄之, 齊藤 隆, 平尾 章, 西村芳孝, 望月英司, 高橋良和(富士電機株) 14. パワーモジュールにおける接合部の高信頼性検討 *増森俊二, 浅田晋助, 村田大輔, 坂元創一, 柳本辰則(三菱電機株) 15. 超音波 Al リボンボンディングにおける凝着界面形成および接合信頼性 *三澤浩太(大阪大学), 高岡勇介(大阪大学), 前田将克(日本大学), 高橋康夫(大阪大学) 16. パワーモジュールにおけるワイヤ接合部の簡易寿命推定手法の開発 *伊藤悠策, 大本洋平, 田屋昌樹, 花田隆一郎, 内田祥久, 折田昭一(三菱電機株) 17. プレスフィット端子形状と表面処理が接触抵抗に及ぼす影響 *深田健太郎 ¹ , 江草稔 ² , 福本信次 ¹ , 松嶋道也 ¹ , 加柴良裕 ² , 藤本公三 ¹ (¹ 大阪大学 ² 三菱電機株)	[B-3] 信頼性評価技術 41. 鉛フリーはんだ材の低サイクル疲労強度におよぼすひずみ速度の影響 *藤野友也, 折山弘和, 川上 崇, 木下貴博(富山県立大学) 42. Bi-Sn 共晶合金の微小疲労き裂進展におよぼすひずみ速度および温度の影響 *谷口麻衣子, 荻谷義治(芝浦工業大学) 43. 鉛フリーはんだ用の汎用構成モデルが示す力学的特性とはんだ接合部の累積非弾性ひずみ挙動 林 文晴,*高部真彰(東京工業高等専門学校), 海老原理徳(東京学芸大学), 渡邊裕彦, 浅井竜彦(富士電機株), 志村 穰(東京工業高等専門学校) 44. FIB-SEM による3次元観察を用いた Cu ピラーフリップチップ接合部の信頼性評価 *伊藤元剛, 石川純久, 上野義弘, 加藤 淳(株東レリサーチセンター) 45. 実験計画法を用いた銅製スルーホール熱疲労強度に関する検討 *岩出翔伍, 木下貴博, 川上 崇(富山県立大学), 水科秀樹, 飯長 裕(沖電気株式会社) 46. 膨潤環境におけるエポキシ樹脂/Si 接合部の熱疲労解析 *高橋秀人, 荻谷義治(芝浦工業大学)	[C-3] マイクロ接合・加工 69. CIP 法を用いたアルミニウムのレーザ溶接時におけるキーホール形成と溶融金属の流動に関する三次元数値解析 *周崎楓, 堀尾克磨, 宮坂史和, 森 裕幸, 水谷正海, 川人洋介, 片山聖二(大阪大学) 70. レーザ処理表面微細クレバス構造を利用した化合物生成を伴う特異拡張濡れによる金属接合の試み *中本将嗣, 福田 敦(大阪大学), Jenna Pinkham(UC), Siboniso Vilakazi, 後藤弘樹, 松本 良, 宇都宮裕, 田中敏宏(大阪大学) 71. ピコ秒パルスレーザを用いたガラスの微細溶接特性に及ぼす集光条件の影響 *岡本康寛, Imaduddin Helmi Wan Nordin, 太田元基, 篠永東吾, 岡田 晃(岡山大学) 72. 光造形アディティブマニファクチャリングによるセラミックス成形 *桐原聡秀, 野中公貴(大阪大学) 73. Ni-Co Al クラッド材を用いたシリサイド系熱電素子と電極の接合 *東平知丈, 藤原伸一(株日立製作所) 74. 誘導加熱を用いたロウ付け自動化技術によるモノづくり革新 *越智正三, 前川幸弘, 五閑学(パナソニック株)
10:50	休 憩		
11:00 ~ 12:40	[A-4] ナノ・マイクロマテリアル 18. 定電位電解した Au ナノポーラスシートによる Cu/Cu 接合の検討 *松永香織, Kim Min-Su, 西川 宏(大阪大学), 斎藤美紀子, 水野 潤(早稲田大学) 19. 酸化還元によるその場生成 Ag ナノ粒子の焼結を利用した金属-セラミックス接合 *本山啓太, 佐野智一, 廣瀬明夫(大阪大学) 20. 低温焼成に向けた銅微粒子系 *米澤徹, 塚本宏樹(北海道大学) 21. 銀ナノポーラス材料を用いた接合部の高温放置試験による微細組織変化 *Kim Min-Su, 西川 宏(大阪大学) 22. 界面ケミストリ制御によって誘導される導電性接着剤におけるAgマイクロ粒子の低温焼結現象 *坂庭慶昭, 飯田将基, 多田泰徳, 井上雅博(群馬大学)	[B-4] システム化 47. 【講演】産業・インフラ市場における半導体ビジネスの課題と挑戦 ~初期マーケティングにかかせない部品実装技術の重要性~ *大幸幸成(株東芝) 48. ミニマルファブによるウェアプロセッサからパッケージングプロセスまでの統合生産システム *居村史人 ^{1,2} , 東野泰英 ² , 寶池広由 ² , 北山侑司 ² , 数佐純子 ² , 井上道弘 ¹ , 猿渡新水 ^{1,2} , Somnawan Khumpuang ^{1,2} , 原 史朗 ^{1,2} (¹ 産業技術総合研究所, ² ミニマルファブ技術研究組合) 49. 製品・製造統合モデルによるパッケージ構造適正化に関する研究 *岩田剛治, 村田秀則, 瀧美幸一郎, 佐藤了平(大阪大学) 50. 次世代システム LSI 概略設計への階層型最適化手法の適用 *寺田論史, 岩田剛治, 佐藤了平, 村田秀則, 河村 憲(大阪大学)	[C-4] 回路基板・パッケージ 75. 【講演】2. 1D/2. 5D-IC 向け高信頼性配線の開発 *神吉剛司, 池田淳也, 中田義弘, 谷元昭, 中村友二(株富士通研究所) 76. 高速伝送用 FPC における BGA 接続構造の電気特性 *赤星知幸, 福盛大雅, 水谷大輔, 谷 元昭(株富士通研究所) 77. Embedded Device Package の熱設計に向けた配線デザインの発熱特性 *松原寛明, 近井智哉, 林 直毅, 岩崎俊寛, 谷口文彦(株ジェイデバイス) 78. Wafer Level Package のはんだ接合信頼性に及ぼす材料特性とパッケージ仕様の影響 *立花 賢, 野村 光, 吉川俊策, 齋藤 岳(千住金属工業株)
12:40	昼 食 休 憩		
13:40 ~ 15:20	[A-5] パワーデバイス(2) 23. SiCパワーデバイス向け銅ナノシッター接合材の開発とその評価 *福本邦宏, 小山優(協立化学産業株) 24. 銀ナノ粒子を用いた接合材料による 200°C 信頼性の確立 *渡辺智文, 武居正史(バンドー化学株) 25. Ag ナノ粒子焼結体の塑性変形挙動におよぼす焼結温度の影響 *塩田竜太郎, 荻谷義治(芝浦工業大学), 水村宜司, 佐々木幸司(ナミックス株) 26. パワーモジュールの焼結 Ag 接合部の破壊メカニズムに関する調査 *福本晃久, 田中陽, 横山吉典, 谷垣剛同, 西川和康(三菱電機株)	[B-5] MEMS・医療センサ(1) 51. 【講演】3次元UVリソグラフィとそのバイオ応用 *鈴木孝明(群馬大学) 52. 唾液中グルコース計測のためのマウスガード型バイオセンサ「キャピタセセンサ」 *荒川貴博, 仁田大揮, 黒木祐輔, 當麻浩司, 三林浩二(東京医科歯科大学) 53. 低侵襲医療機器のための細径円筒形状パッケージングを目的とした非平面実装技術の開発 *大内順平, 松永忠雄, 芳賀洋一(東北大学) 54. MEMS 熱流束センサによるウェアラブル深部体温計の提案 *中川慎也, 濱口剛(オムロン株), 清水正男(オムロンヘルスケア株)	[C-5] 3D実装 79. 3次元集積デバイスにおける座屈を考慮した薄化チップの変形モデル *土手 暁, 北田秀樹, 水島賢子, 森田将, 中村 誠, 中村友二, 作山誠樹(富士通株) 80. 高分子絶縁膜を用いたはんだによるシリコン貫通ビア *堀部晃啓, 末岡那昭, 青木豊広, 小原さゆり, 岡本圭司, 森 裕幸, 折井靖光(日本アイ・ビー・エム株) 81. 高密度3次元実装に向けたフィラー含有樹脂とパンプのハイブリッド接合技術 *大山真輝, 仁村将次, 庄子習一(早稲田大学), 田村 護, 榎本智之(日産化学工業株), 重藤 暁津(物質材料研究機構), 水野 潤(早稲田大学) 82. Cu 核ボールの接合における核部の偏心制御方法 *服部貴洋, 六本木貴弘, 相馬大輔, 佐藤 勇(千住金属工業株) 83. 有限要素解析によるガラスインターポーザ実装基板の熱応力解析 *窪田悠人, 荘司郁夫(群馬大学), 土田徹勇起, 中村清智(凸版印刷株)
15:20	Coffee Break		
15:40 ~ 17:00	[A-6] パワーデバイス(3) 27. ナノスプリング層を用いた熱変形を吸収する高信頼実装構造 *谷江尚史(株日立製作所), 澄川貴志, 北村隆行(京都大学) 28. 鉛フリーはんだ接合部の鉛直方向割れ耐性評価 *田中 陽, 福本晃久, 遠藤加寿代, 田屋昌樹, 山崎浩次, 西川和康(三菱電機株) 29. ピラー状 IMC 分散鉛フリーはんだ接合部の組織と接合強度 *林 和, 荘司郁夫(群馬大学), 中田裕輔, 橋本富仁(株カルソニックカンセイ) 30. パワーモジュール向けピラー状 IMC 分散鉛フリーはんだ接合部の開発 *中田裕輔, 橋本富仁(株カルソニックカンセイ), 林 和, 荘司郁夫(群馬大学)	[B-6] MEMS・医療センサ(2) 55. 小型光マイクロエンコーダをめざしたワイヤグリッド偏光子を集積した偏光センサによる回転角検出 *池田 颯, 日暮崇治, 須賀唯知(東京大学) 56. 先端デバイス製造の為の直接接合技術に関する研究 *黒瀧宏和(イーヴィグループジャパン株) 57. 橋掛け構造により高い擦り耐性を実現するガラスナノピラー構造の作製 *須藤健成, 岡田愛姫子, 桑江博之(早稲田大学), 高山公介(旭硝子株), 庄子習一, 水野潤(早稲田大学) 58. 微量分子検出のための高次ナノ構造体の創製と実装 *山口明啓, 福岡隆夫, 内海裕一(兵庫県立大学)	[C-6] めっき 84. 電解 Cu めっきの前処理工程における、酸素ブラスマ処理の不安定要因解析 *佐藤祐司, 藤田淳, 遠藤加寿代, 吉田基, 西川和康(三菱電機株) 85. (001)優先配向を示す銀めっき皮膜のセルフアニーリング挙動その場観察 *林 佑美, 荘司郁夫(群馬大学), 宮澤 寛(DOWA 金属テクノ株) 86. 無電解 Ni/Pd/Au めっきにおけるはんだボール接続信頼性-無電解 Pd めっき膜厚の影響- *江尻芳則, 納堂高明, 高橋昭男, 櫻井健久(日立化成株), 荒山貴慎(日立化成エレクトロニクス株), 坪村良明, 長谷川清(日立化成株) 87. 無電解 Ni-B めっき UBM のはんだバリア特性と接合強度の検討 *森田 将, 赤松俊也, 作山誠樹(富士通株)
17:00 ~ 17:20	表彰式 (A会場) 閉会の挨拶 Mate2016組織委員会副委員長 青柳 昌宏 (A会場)		

※ 掲載内容は、当日変更される場合があります。

組織委員会

委員長	： 藤本公三 (大阪大学)		
副委員長	： 青柳昌宏 ((独)産業技術総合研究所)	廣瀬明夫 (大阪大学)	
委員	： 瀧美幸一郎 (大阪大学)	荒井栄司 (大阪大学)	大西 寛 (三菱電機(株))
	小勝俊亘 (日本電気(株))	小林紘二郎 ((一財)電子科学研究所)	齋藤重正 (合同会社70ティア・アライツ)
	佐藤武彦 (大阪大学)	佐藤了平 (大阪大学)	嶋田勇三 (ナミックス(株))
	菅沼克昭 (大阪大学)	高橋康夫 (大阪大学)	竹本 正 (大阪大学)
	田中敏宏 (大阪大学)	寺前俊哉 ((株)日立製作所)	西田一人 (パナソニック(株))
	貴井 孝 (大阪大学)	二上範之 (シャープ(株))	益子原學 ((株)サイキューブ)
	松村慶一 (インフィテックエム(株))	南二三吉 (大阪大学)	南尾匡紀 (パナソニック(株))
	宮崎則幸 (北九州市産業局)	森 郁夫 ((株)東芝)	矢野 映 ((株)富士通研究所)
	山本治彦 (富士通ICT(株))	吉田 隆 (富士電機(株))	

実行委員会

委員長	： 加柴良裕 (大阪大学)		
副委員長	： 上西啓介 (大阪大学)	久保雅男 (パナソニック(株))	福本信次 (大阪大学)
委員	： 青島正貴 (トヨタ自動車(株))	赤松俊也 ((株)富士通研究所)	浅井康富 ((株)デンソー)
	朝倉義裕 (神戸市立工業高等専門学校)	新井 進 (信州大学)	池田 徹 (鹿児島大学)
	出田吾朗 (三菱電機(株))	市村裕司 (富士電機(株))	一山靖友 (日鉄住金アノゾー(株))
	伊藤元剛 ((株)東レ(センター))	井上雅博 (群馬大学)	岩田剛治 (大阪大学)
	于 強 (横浜国立大学)	梅本和伸 (日本電気(株))	海老原伸明 (NECシステム(株))
	大口達也 (日本アビオニクス(株))	大熊秀雄 ((有)エイチ・ティー・オー)	大貫 仁 (茨城大学)
	大村悦二 (大阪大学)	小川倉一 (小川創造技術研究所)	小椋 智 (大阪大学)
	小野雅史 (ニホンハンダ(株))	折井靖光 (日本アイ・ビー・エム(株))	鎌田信雄 (化研テック(株))
	苅谷義治 (芝浦工業大学)	菅野敏之 ((株)MORESCO)	河野英一 ((株)河野エムイー研究所)
	小山真司 (群馬大学)	阪元智朗 (オムロン(株))	作山誠樹 ((株)富士通研究所)
	佐藤 強 ((株)東芝)	佐名川佳治 (パナソニック(株))	佐野智一 (大阪大学)
	穴戸逸朗 (京セラ・キートンソリューション(株))	柴崎正訓 ((株)タムラ製作所)	澁谷忠弘 (横浜国立大学)
	莊司郁夫 (群馬大学)	角谷 透 ((株)船井電機応用技術研究所)	節原裕一 (大阪大学)
	芹沢弘二 (千住金属工業(株))	高尾尚史 ((株)豊田中央研究所)	高岡英清 ((株)村田製作所)
	高橋邦夫 (東京工業大学)	武井利泰 (日本精工(株))	津久井勲 (リサーチラボ・ツクイ)
	戸井恵子 (エスベック(株))	富岡泰造 ((株)東芝)	富村壽夫 (熊本大学)
	豊田良孝 (千住金属工業(株))	中村清智 (凸版印刷(株))	西浦正孝 (パナソニック(株))
	西川 宏 (大阪大学)	久田隆史 (日本アイ・ビー・エム(株))	弘田実保 ((株)村田製作所)
	藤原伸一 ((株)日立製作所)	松坂壮太 (千葉大学)	松嶋道也 (大阪大学)
	松林 良 (新電元工業(株))	圓尾弘樹 (パナソニック(株))	水野 潤 (早稲田大学)
	宮澤 寛 (DOWA(株))	村井淳一 (三菱電機(株))	村山 啓 (新光電気工業(株))
	森 貴裕 ((株)ADEKA)	安田清和 (大阪大学)	山内 啓 (群馬工業高等専門学校)
	山口敦史 (パナソニック(株))	山下志郎 ((株)日立製作所)	山中公博 (中京大学)
	山根常幸 ((株)東レ(センター))	山部光治 ((株)東芝)	横沢伊裕 (宇部興産(株))
	渡邊 聡 (藤倉化成(株))	渡辺 潤 (長野沖電気(株))	渡邊裕彦 (富士電機(株))

(依頼中を含む)

会場アクセス

パシフィコ横浜 会議センター

- * みなとみらい線 みなとみらい駅より徒歩3分
- * JR線・市営地下鉄 桜木町駅より徒歩12分
- * 横浜駅よりタクシー7分、シーバス(船)で10分



問い合わせ先：Mate 2016 事務局

(TEL) 06-6878-5628, (FAX) 06-6879-7568

(E-mail) mate@sps-mste.jp, (URL) <http://sps-mste.jp/mate2016/src/>